

裕太微电子  
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

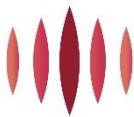
证券代码：688515

证券简称：裕太微

## 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YT\_ZQSWB\_2024\_7\_8

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 公司现场接待 <input type="checkbox"/> 电话接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与人员单位名称及姓名	德邦基金管理有限公司，李薇依 泰信基金管理有限公司，黄睿东 开源证券股份有限公司，李琦
日期时间	2024年7月24日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董秘办顾问：程婧偲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p>一、介绍环节</p> <p>首先就公司2023年年度及2024年一季度经营情况做简要说明。</p> <p>二、互动交流环节</p> <p>1、新能源带动充电桩的增量，公司产品有用到这里面么？</p> <p>答：根据中国充电联盟最新发布的数据，2024年6月，国内公共充电桩的数量环比增长了7.23万个，同比增长率较去年同期提升了12%，年度累计增量达到了40万个，同比增长率为13%。私人充电桩6月环比增长了24.7万个，年累计增量为125万个，同比增长15%。按照当前的市场增量，中国纯电动车的充电桩比已经达到了1:1，纯电动乘用车与公共充电桩的增量比例为1.4:1，若按照一个公共充电桩至少服务三辆车的标准，充</p>



电体系的车桩比基本达到 1:1。公司百兆以太网物理层芯片已批量应用到充电桩中，后续也将随着充电桩使用量的增加而增加。

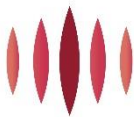
## 2、特斯拉 FSD v12.5 版本有说要推送给非员工车主，这个对公司车载事业有帮助么？

答：特斯拉 FSD，全称 Full Self-Drive（完全自动驾驶），目前特斯拉推出了三个辅助驾驶产品，分别是 AP（自动辅助驾驶）、EAP（增强版自动辅助驾驶），和 FSD。其中 AP 最为基础，EAP 则是增强辅助驾驶，能够提供智能召唤、自动泊车、自动辅助巡航等功能。FSD 作为特斯拉技术等级最高的辅助驾驶能力，能够提供导航辅助驾驶、自动变道、自动泊车、智能召唤、交通信号识别等功能，这些能力目前国内部分新能源品牌都已经具备并已上路使用。FSD 的推广将在很大程度上推动车载以太网快速渗透到汽车行业，加快从 L2 早期时代跨入 L4 甚至 L5 的汽车智能化水平，大幅增加以以太网为主干的第三代汽车应用中对车载以太网产品的应用，对公司车载以太网系列产品的发展有较大的推广意义。

## 3、目前国内汽车芯片标准制定情况？

答：目前国内汽车芯片标准制定进程正在加快，超 20 项相关标准已立项申请或启动。今年 1 月，由中国工业和信息化部办公厅编制印发的《国家汽车芯片标准体系建设指南》出炉，文件提出，到 2025 年，中国要制定 30 项以上汽车芯片重点标准；到 2030 年，制定 70 项以上汽车芯片相关标准。2023 年，公司骨干参加 IEEE 802.3 标准制定讨论，成为国际以太网技术领域标准制定的参与者之一。由公司牵头起草的《道路车辆车载以太网第 2 部分：通用物理实体要求》和《道路车辆车载以太网第 6 部分：100Mbit/s 电气物理层实体技术要求和一致性测试规程》的标准草案顺利通过全国汽车标准化技术委员会电子与电磁兼容分技术委员会起草组专家审核。公司在标准参与制定、终端客户需求勘探、生态圈建设、产学研合作等多个维度进行资源整合和应用。

## 4、请介绍一下公司车载千兆以太网物理层芯片的先进性



	<p>答：公司车载千兆以太网物理层芯片（YT8011A）采用先进的混合信号技术和模拟前端（AFE），通过 UTP 电缆实现高速数据传输和接收。该芯片实现了自适应均衡、串扰消除、回波消除、数据恢复和纠错等功能，以及 100Mbps 或 1000Mbps 的强大传输和接收能力。它提供高静电放电（ESD）保护，以及优异的电磁兼容性（EMC）性能。其核心先进点包括高等级的 ESD 防护等级、超低功耗的睡眠模式和超强的干扰抑制能力等，均已达到同类产品中的国际领先水平。</p> <p><b>5、公司在产学研方面的工作？</b></p> <p>答：2023 年 12 月，公司与南京邮电大学共同创办以太网传输芯片研发中心，标志着双方将共同推动以太网传输芯片的高质量发展，促进校企合作，实现优势互补，共同培育核心技术研发人才，推动高校科研成果转化，为我国集成电路产业的持续发展提供强大的技术支持和人才保障。与高校联合共建研发中心，通过校企合作，公司不仅将加快研发速度，提高科研成果转化率，还将为培养下一代核心技术研发人才奠定坚实基础，进一步深化产学研工作，达到优势互补、共同发展的双赢局面。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>

